

厦门优迅芯片股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称本公司或公司）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2397 号），并经上海证券交易所同意，本公司于 2025 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 51.66 元，募集资金总额为人民币 103,320.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,551.17 万元后，实际募集资金金额为 92,768.83 万元。该募集资金已于 2025 年 12 月 12 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0063 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金的使用和结余

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 147,128,017.39 元，其中往期投入及置换 86,877,592.25 元，本期使用 60,250,425.14 元。募集资金余额 782,889,622.56 元，其中现金管理余额 547,800,000.00 元，募集资金专户 2026 年 06 月 30 日余额合计为 235,089,622.56 元。

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	1,033,200,000.00
其中：超募资金金额	118,623,307.50
减：发行费用（不含税）	105,511,678.19
二、募集资金净额	927,688,321.81
减：以前年度使用金额	86,877,592.25
本期使用金额	60,250,425.14
购买理财	1,062,430,000.00

加：理财到期	514,630,000.00
累计利息、理财收入（扣除手续费净额）	2,329,318.14
三、募集资金专户余额	235,089,622.56

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年12月，本公司与厦门银行股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年12月，公司、武汉芯智光联科技有限公司（本公司全资子公司）与中信银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行及中信证券分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2026年6月，公司、武汉芯智光联科技有限公司（本公司全资子公司）与中国建设银行股份有限公司厦门市分行及中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年06月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

主体	账户	账号	余额	存储形式
厦门优迅芯片股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门科技支行	35150198870109688807	5,866.21	活期
厦门优迅芯片股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040075296	5,893.29	活期
厦门优迅芯片股份有限公司	厦门银行股份有限公司鹭通支行	80133416000295	2.11	活期
厦门优迅芯片股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门软件园支行	592903489410007	68.52	活期

武汉芯智光联科技有限公司	中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	17060101040041256	1,164.77	活期
武汉芯智光联科技有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040075221	9,957.96	活期
武汉芯智光联科技有限公司	中信银行股份有限公司厦门分行	8114901013200212315	516.05	活期
武汉芯智光联科技有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门科技支行	35150198870109216888	40.06	活期
合计			23,508.96	

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2026 年 06 月 30 日止，本报告期公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,025.04 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司及实施募投项目的子公司基本存款账户或一般存款账户进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构发表了同意置换意见。本报告期内，公司以募集资金置换使用自有资金支付募集资金投资项目的金额为 1,556.48 万元。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，不超过人民币 70,000 万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单及收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

截至 2026 年 06 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 54,780 万元（不含以协定存款形式存放金额），具体明细如下：

金额单位：人民币万元

委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买日	到期日	购买金额
厦门优迅芯片股份有限公司	厦门银行股份有限公司鹭通支行	单位大额存单 2026 年第 018 期（9 个月）	大额存单	2026-2-6	2026-11-6	5,780.00
厦门优迅芯片股份有限公司	平安证券股份有限公司	收益凭证	收益凭证	2026-3-31	2026-9-28	5,800.00
厦门优迅芯片股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门软件园支行	大额存单 9 个月可转让	大额存单	2026-2-10	2026-11-10	6,000.00
厦门优迅芯片股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门科技支行	大额存单 2025 年 055 期	大额存单	2026-2-4	2026-11-3	5,000.00
厦门优迅芯片股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券固收安享系列 639 期收益凭证	收益凭证	2026-5-21	2026-8-21	8,000.00
厦门优迅芯片股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门科技支行	结构性存款	结构性存款	2026-5-7	2026-8-10	5,000.00
武汉芯智光联科技有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	大额存单 9 个月可转让	大额存单	2026-2-4	2026-11-4	5,000.00
武汉芯智光联科技有限公司	中信银行股份有限公司厦门	330 天结构性存款	结构性存款	2026-2-6	2027-1-3	10,000.00

	分行					
武汉芯智光联科技有限公司	中信银行股份有限公司厦门分行	92 天结构性存款	结构性存款	2026-4-7	2026-7-7	2,200.00
武汉芯智光联科技有限公司	中信银行股份有限公司厦门分行	60 天结构性存款	结构性存款	2026-5-21	2026-7-20	2,000.00
合计						54,780.00

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

八、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目，亦不存在募投项目对外转让或者置换情况。

九、节余募集资金使用情况

无

十、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2026 年 08 月 25 日

附表 1:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

	募集资金总额				92,768.83		本年度投入募集资金总额					6,025.04	
	变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					14,712.80	
	变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目	研发项目	不适用	46,780.65	46,780.65	46,780.65	4,220.03	11,361.17	-35,419.48	24.29%	2029年7月	不适用	不适用	否
车载电芯片研发及产业化项目	研发项目	不适用	16,908.47	16,908.47	16,908.47	251.89	840.40	-16,068.07	4.97%	2029年7月	不适用	不适用	否
800G 及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目	研发项目	不适用	17,217.38	17,217.38	17,217.38	1,553.12	2,511.23	-14,706.15	14.59%	2029年7月	不适用	不适用	否
超募资金	其它	不适用	11,862.33	11,862.33	-	-	-	-	-	—	—	—	—
合计	—	—	92,768.83	92,768.83	80,906.50	6,025.04	14,712.80	-66,193.70	18.18%	不适用	不适用	不适用	否
	未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
	项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

	募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见：四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见：五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
	用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
	募集资金结余的金额及形成原因	不适用
	募集资金其他使用情况	不适用